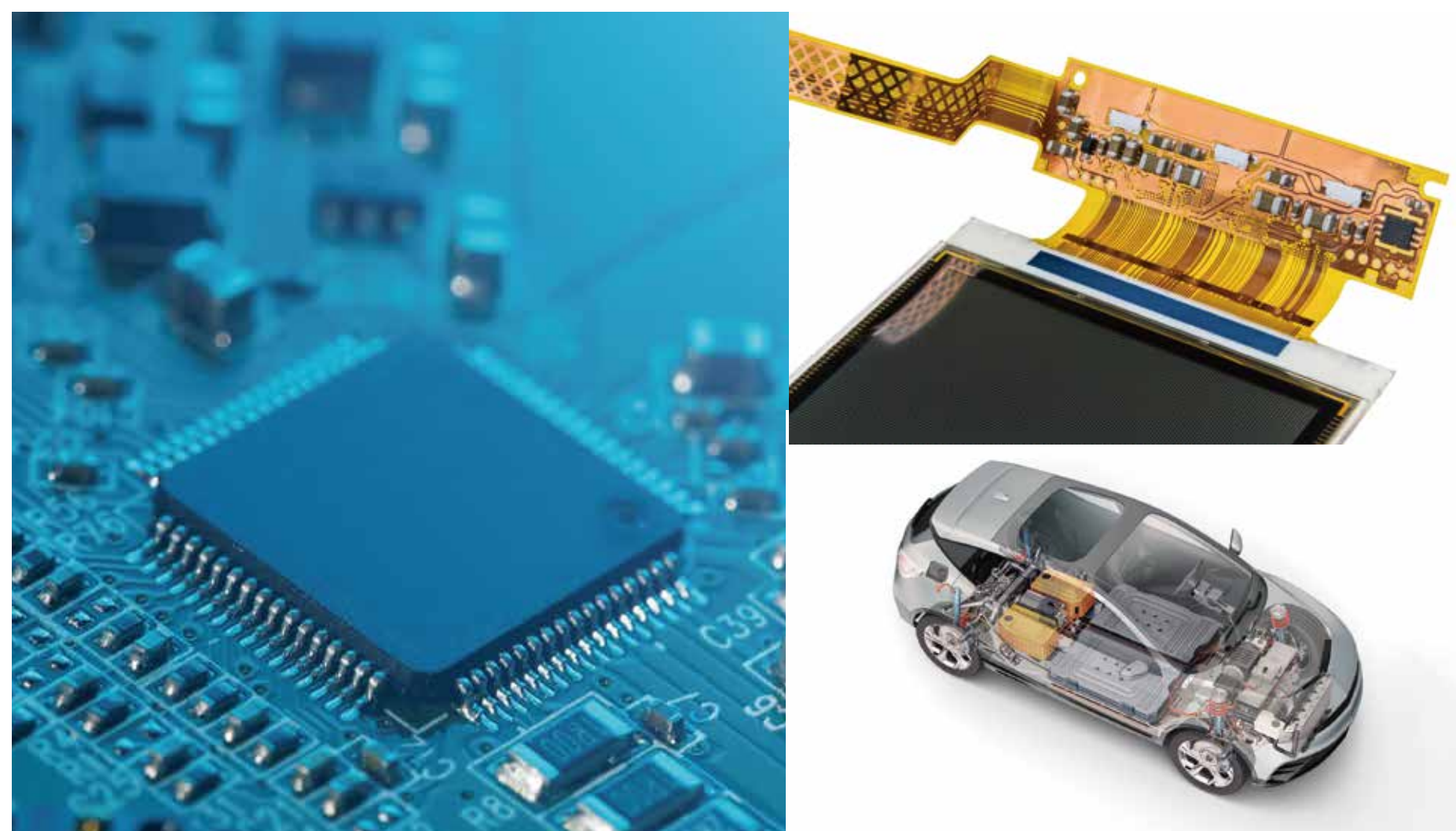


開発品

変性イミド樹脂

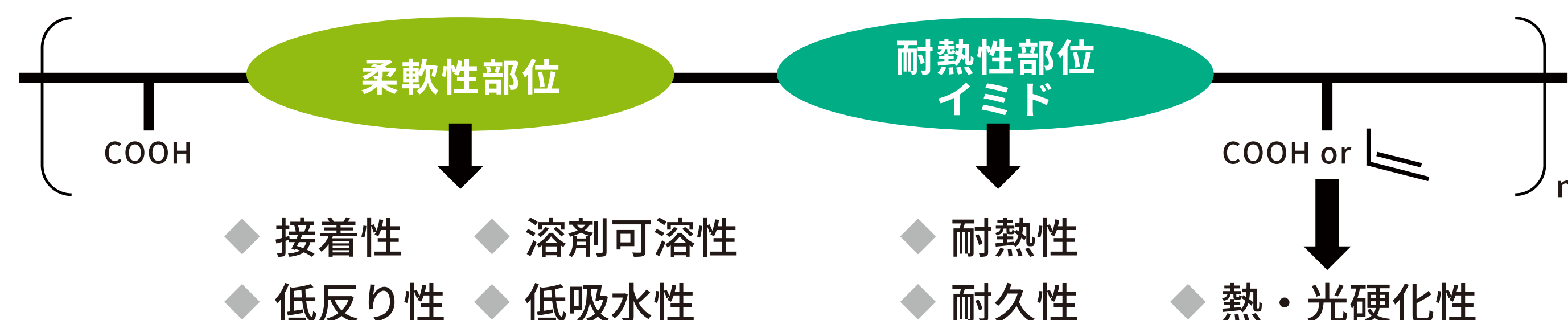
バイオマス由来 エポキシ硬化性



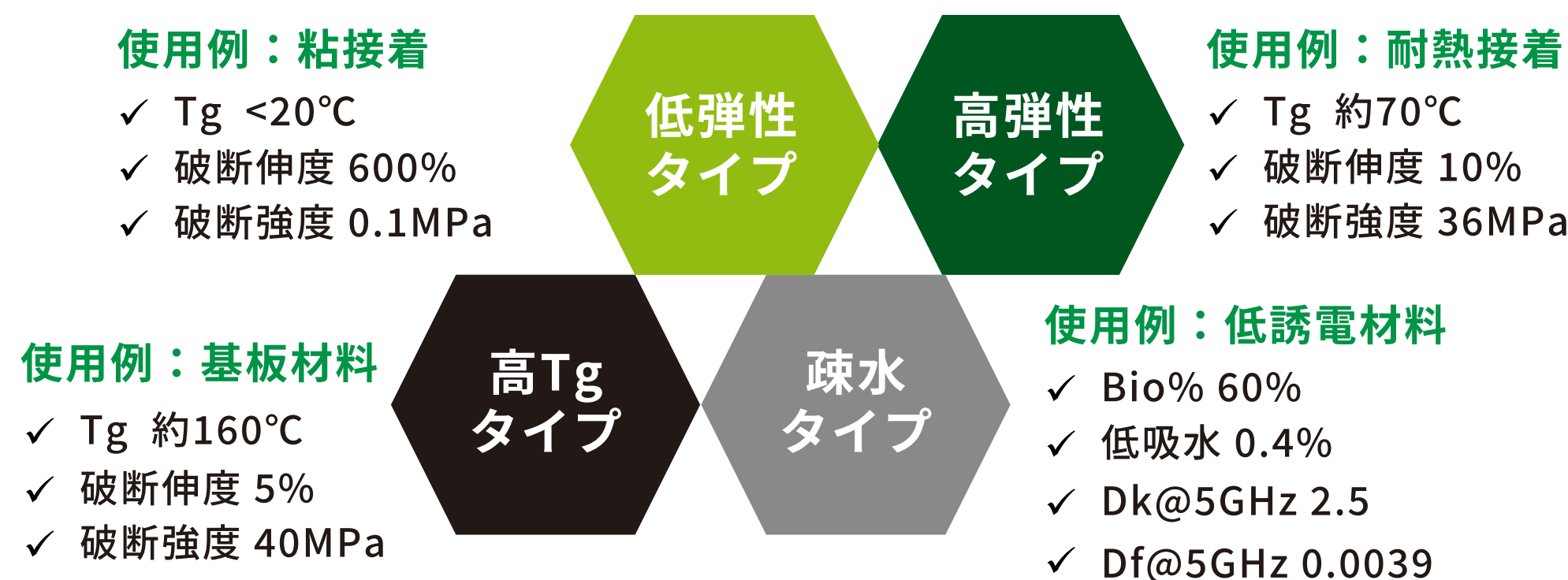
こんな課題を解決します

- バイオマス対応や低温硬化で、環境負荷と生産コストを低減
- 低CTEと応力緩和で、熱サイクルによる反り・クラックを解消
- 車載要求の高耐熱性・低吸水性をクリアし、長期信頼性を実現

変性イミド設計コンセプト



開発品例／特徴



想定用途

- 半導体：バッファコート・再配線材料（RDL）等 絶縁膜
- 実装・基板：パッケージ基板・フレキシブル基板向け 柔軟成分
- 車載モーター等 各種高耐熱絶縁部品

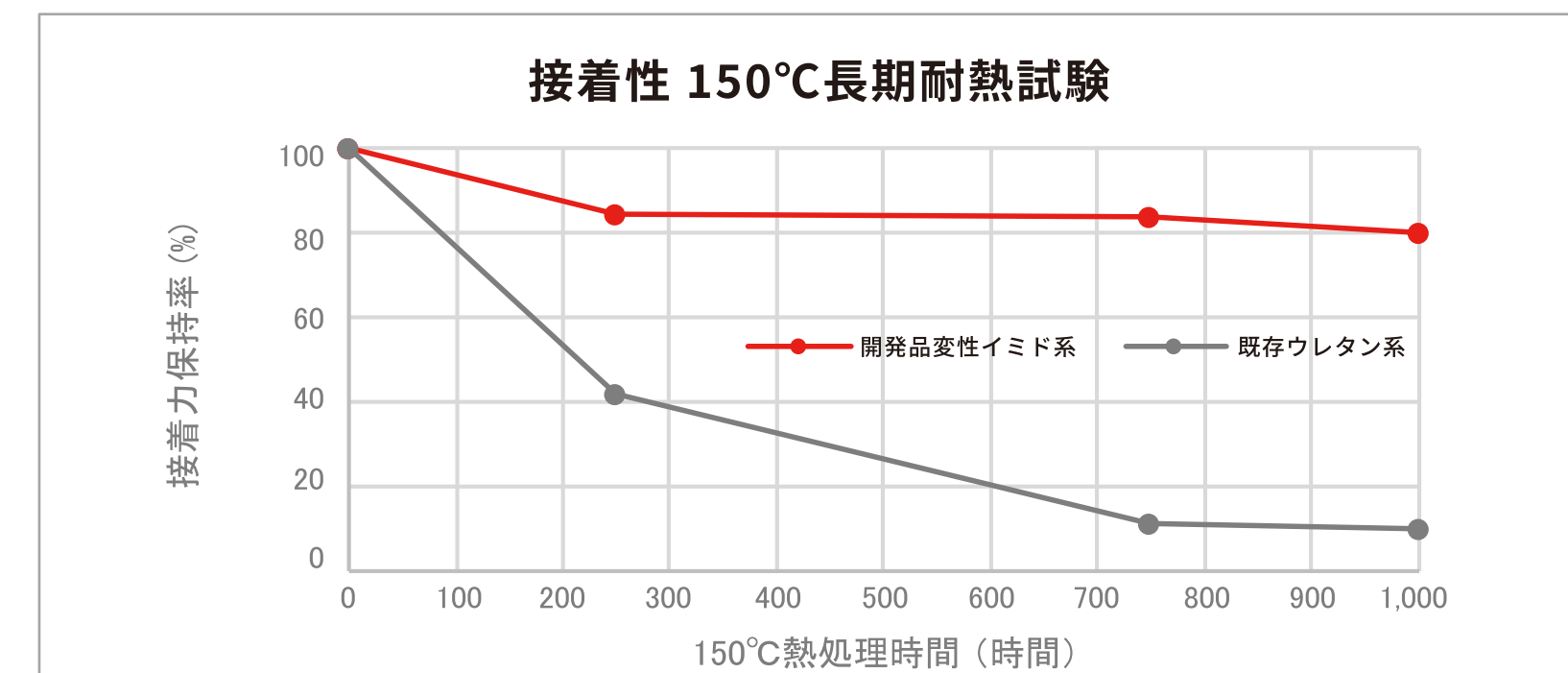
硬化物物性

01 エポキシ硬化後の特性例

		ウレタン系	変性イミド 高弾性品
接着性	Cu	○	○
	PI	○	○
300°C ハンダ耐熱性	乾燥	60秒PASS	180秒PASS
	吸湿	NG	180秒PASS
CTE (ppm/°C)		520	52
吸水率 (%)		1.6	0.4

CTE：25-275°C／吸水率：純水23°C24時間浸漬

02 長期耐熱性



<配合条件> 硬化剤：BPA型エポキシ樹脂 <剥離試験> 基材：銅箔
硬化条件：170°C30分

大日精化工業株式会社 / Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.

ファインポリマー事業部 開発課

Tel: 03-3665-5645 e-mail: fp_daicolor.co.jp-bounces@daicolor.co.jp

※本物性データは、所定の試験方法における当社評価値であり、実際の適用結果を保証するものではありません。